

耐熱疲労性と耐落下衝撃性を両立

Simultaneously realize high thermal fatigue resistance and drop impact reliability

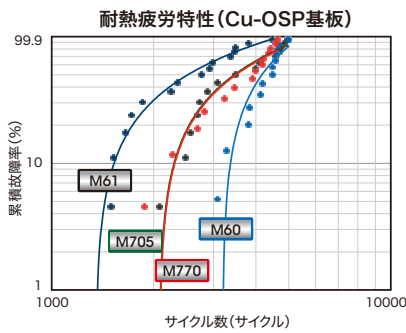
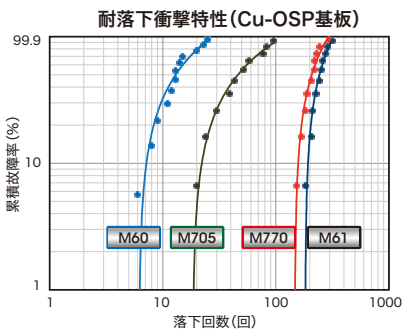
特長

- 析出強化制御と界面反応制御技術で、相反する要求課題を解決
- あらゆる表面処理材料(Cu, Ni, Au)との相性に優れる
- モバイル機器のスマホや、車載用ボール実装に最適

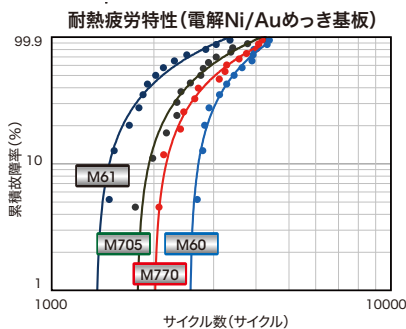
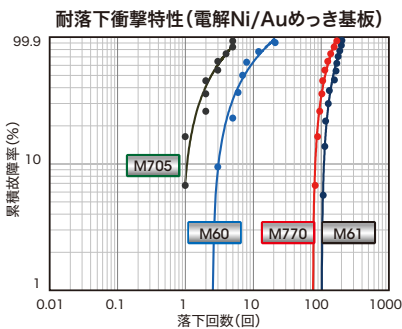


仕様

● Cu-OSP基板での評価



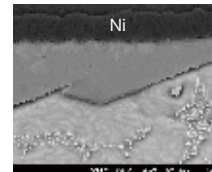
● 電解Ni/Auめっき基板での評価



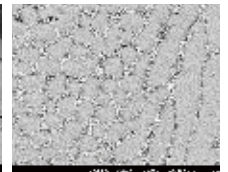
● 各材料の組織

M60

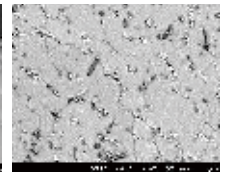
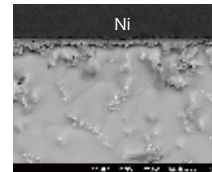
界面組織



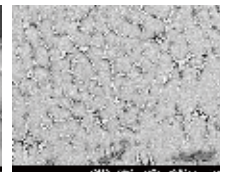
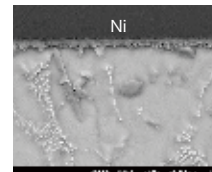
表面組織



M61



M770



● 目的や用途に応じて材料を選択

	M60	M61	M770
耐落下衝撃性	×	◎	◎
耐熱疲労性	◎	×	○

※M705を基準に、相対的に評価した結果を示す

耐熱疲労特性重視 ; M60
 耐落下衝撃特性重視 ; M61
 バランスよく両特性を満たす ; M770